



Strona główna > Wyposażenie serwisu > Sprzęt lutowniczy > Platformy reballing BGA > AMAOE Mbga-B18 BGA platforma do reballingu wraz z sitami dla Qualcomm CPU Snapdragon 855/845/SDM845/SM8150/RAM556

AMAOE Mbga-B18 BGA platforma do reballingu wraz z sitami dla Qualcomm CPU Snapdragon 855/845/SDM845/SM8150/RAM556

ID produktu: 22954

Cena netto: **178,05 PLN**

Cena brutto: **219,00 PLN**

Waga: **1,00 kg**

Opis produktu:

AMAOE Mbga-B18 BGA platforma do reballingu wraz z sitami dla Qualcomm CPU Snapdragon 855/845/SDM845/SM8150/RAM556 Platformy do reballingu to wysokiej jakości produkty, umożliwiające ponowne precyzyjne stworzenie kulek łączących górną oraz dolną część płyty głównej oraz do usuwania kleju. Wykonane z wysokiej jakości kamienia syntetycznego, odporne na wysokie temperatury i szybko schładzającego się.

[Przejdź do produktu](#)

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA



Dane aktualne na dzień 2024-03-19 01:13:02